



主要特点

内部集成 2: 4 译码器

通道数目: 4

通带频率: 10 - 10.9 GHz

10.7 - 12 GHz

11.6 - 13.3 GHz

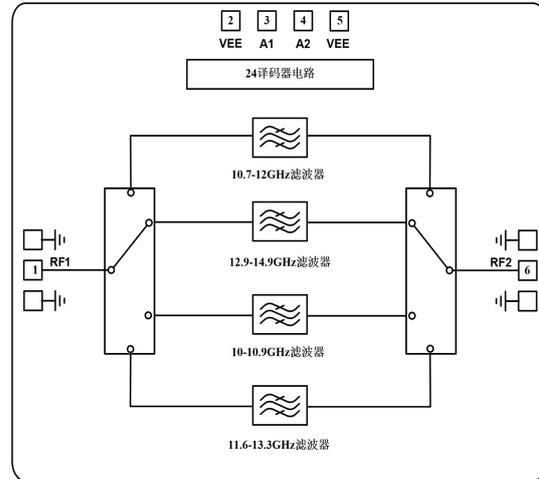
12.9 - 14.9 GHz

功耗: -5 V @ 6 mA

输入 P-1: 21 dBm

芯片尺寸: 2.5 × 3 × 0.1 mm³

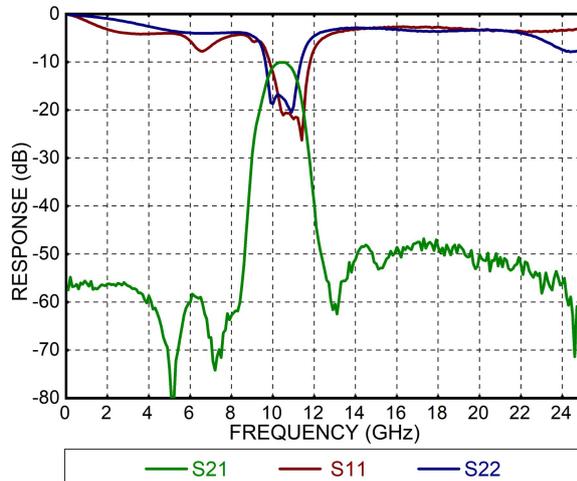
功能框图



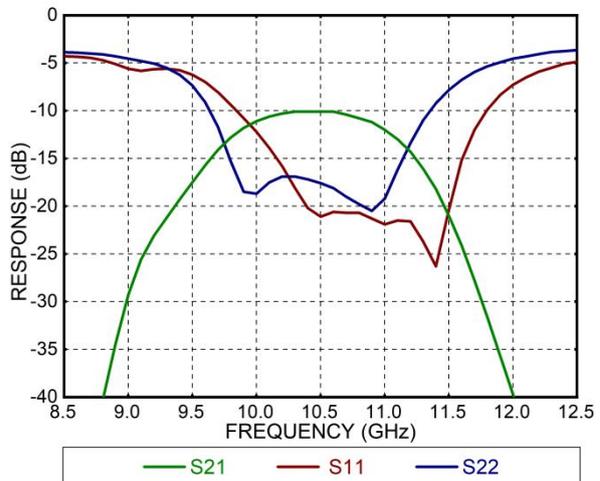
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VEE = -5\text{V}$)

参数	10-10.9GHz	10.7-12GHz	11.6-13.3GHz	12.9-14.9GHz	单位
插入损耗	10	10.6	10.6	10.6	dB
带内平坦度	±0.5	±0.7	±1.3	±0.8	dB
回波损耗	17	12	12	13	dB
带外抑制	45 @ 8.7GHz 45 @ 12.1GHz	45 @ 9.6GHz 45 @ 13.3GHz	45 @ 10.4GHz 45 @ 14.25GHz	45 @ 11.6GHz 45 @ 16GHz	dB

10-10.9GHz反射系数

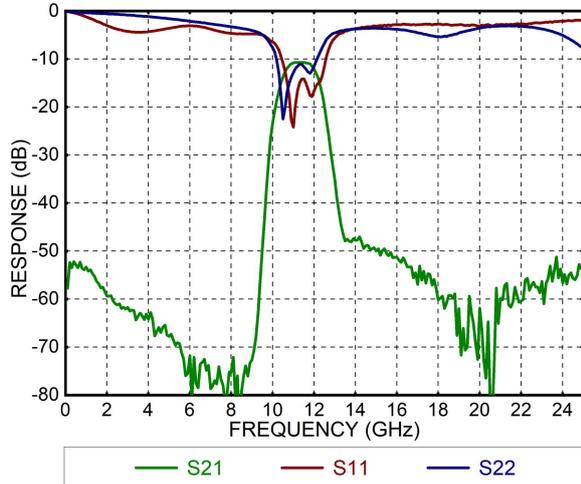


10-10.9GHz反射系数

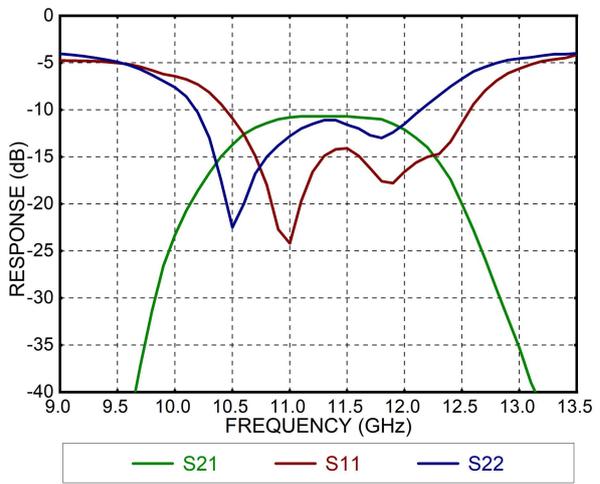




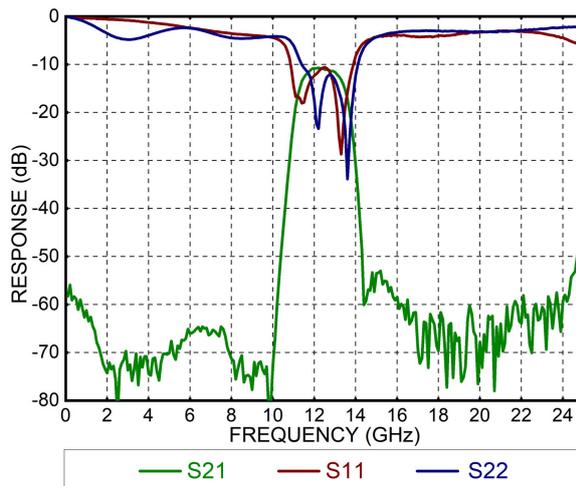
10. 7-12GHz反射系数



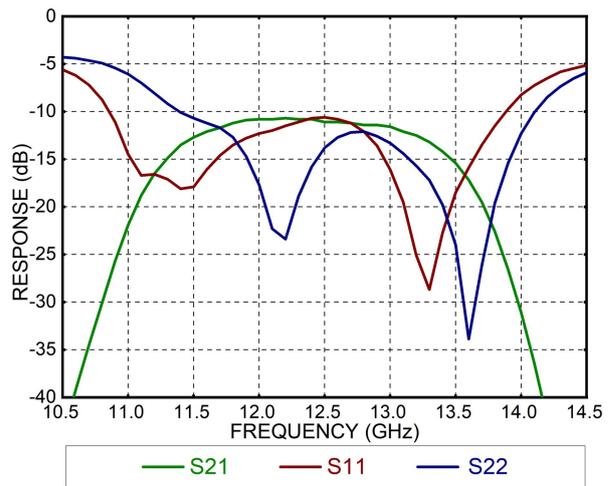
10. 7-12GHz反射系数



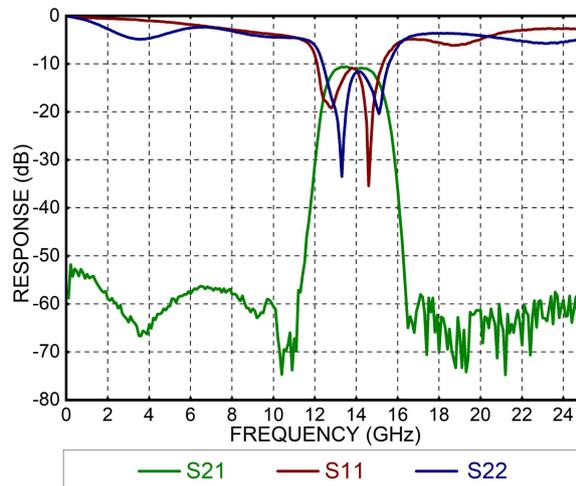
11. 6-13.3GHz反射系数



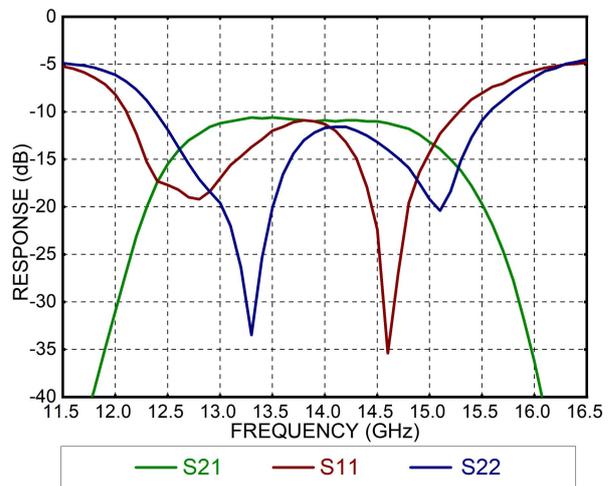
11. 6-13.3GHz反射系数



12. 9-14.9GHz反射系数



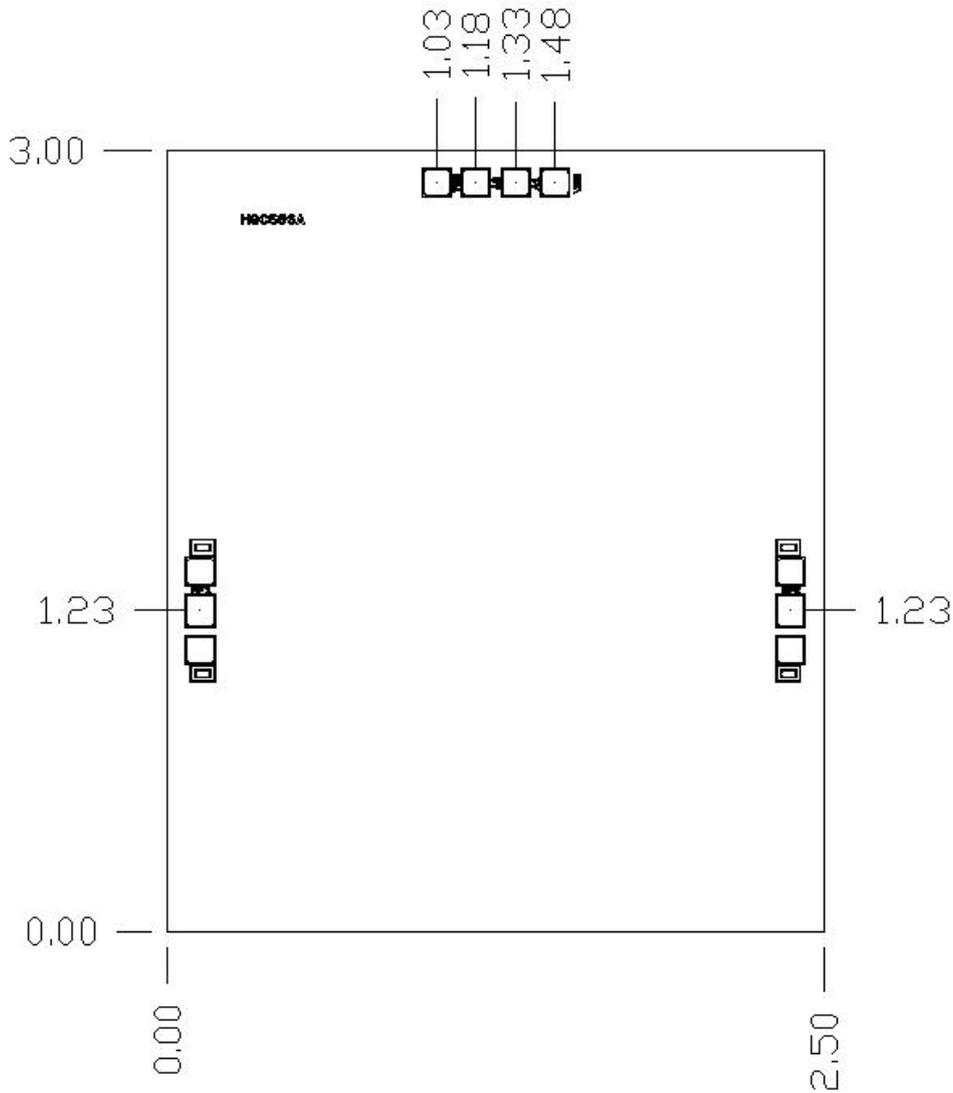
12. 9-14.9GHz反射系数





物理参数

单位: mm



焊盘描述

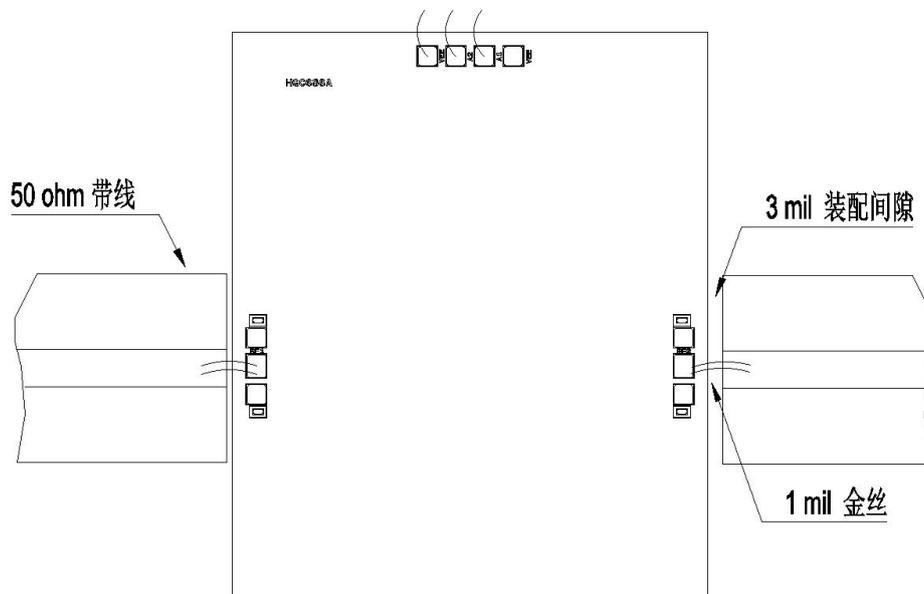
焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
6	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2、5	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3、4	A1、A2	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



真值表

通道	A1	A2
10-10.9 GHz	0	0
10.7-12 GHz	1	0
11.6-13.3 GHz	0	1
12.9-14.9 GHz	1	1
“0”电平范围: 0~0.8 V, “1”电平范围: 2.3~5 V		

推荐装配图



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100 μm
3. 典型键合焊盘尺寸为 $120 \times 100 \mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化: 金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息: 材质: SiN; 厚度: $0.6 \mu\text{m}$

极限参数

1. 电源电压: -6 V
2. 射频输入功率: +27 dBm
3. 储存温度: $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度: $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$